

NEDO の公募事業に採択された 次世代半導体の設計技術開発プロジェクトにキヤノンが参画

キヤノン株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役会長兼社長 CEO：御手洗 富士夫、以下キヤノン）と日本シノプシス合同会社（本社：東京都世田谷区、社長 職務執行者：河原井 智之、以下日本シノプシス）は、研究開発プロジェクト「先端半導体技術を活用した画像処理 SoC 技術開発」に参画します。本プロジェクトはこのたび、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）が公募した「ポスト 5G 情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発（助成）」に採択されました。

本プロジェクトでは、キヤノンの画像処理技術、日本シノプシスの設計技術を融合し、NEDO の支援のもと、次世代半導体の設計技術開発に共同で取り組みます。2nm 世代の微細プロセス技術を基盤に、複数チップを高密度に統合するチップレット技術を組み合わせることで、従来の単一チップ構成では実現が困難であった高性能かつ低消費電力な画像処理 SoC（System on Chip）の設計技術開発を行います。これにより、エッジ端末におけるリアルタイム画像処理や AI 処理の高度化に対応しつつ、省電力化や小型化にも貢献することを目指します。

ポスト 5G 時代の到来により、IoT や自動運転、スマートシティ、遠隔医療など、多様な分野で膨大な画像データのリアルタイム処理が求められています。こうした社会的要請に応えるため、国内外の最先端半導体設計・製造技術を結集し、エッジ端末で高効率な画像処理を可能とする新しい半導体プラットフォームの技術開発に取り組みます。

キヤノンは、長年培ってきた画像処理技術とものづくりの強みを生かし、日本の先端半導体技術開発の加速と産業基盤の強化に貢献します。本プロジェクトを通じて、次世代半導体の研究開発を支え、イメージングや AI 分野で技術の発展に寄与します。

〈プロジェクトの概要〉

事業名：ポスト 5G 情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発（助成）

研究開発テーマ名：先端半導体技術を活用した画像処理 SoC 技術開発

実施体制：日本シノプシス合同会社

キヤノン株式会社

研究期間：研究開発開始時点から原則 5 年（60 か月）以内

〈参考〉

NEDO「ポスト 5G 情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発（助成）」の実施体制の決定について https://www.nedo.go.jp/koubo/IT3_100371.html